

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 3 区分

【発行日】平成28年10月13日 (2016.10.13)

【公開番号】特開2015-42001(P2015-42001A)

【公開日】平成27年3月2日 (2015.3.2)

【年通号数】公開・登録公報2015-014

【出願番号】特願2013-173920(P2013-173920)

【国際特許分類】

H 0 3 F 1/56 (2006.01)

H 0 3 H 11/28 (2006.01)

H 0 3 H 7/38 (2006.01)

H 0 3 F 3/195 (2006.01)

H 0 3 F 3/60 (2006.01)

【 F I 】

H 0 3 F 1/56

H 0 3 H 11/28

H 0 3 H 7/38 C

H 0 3 F 3/195

H 0 3 F 3/60

【手続補正書】

【提出日】平成28年8月22日 (2016.8.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

上面に信号配線、および接地パターンを有する基板と、

前記基板の上面に設けられ、出力端子を備え、前記出力端子が前記信号配線に接続された半導体チップと、

前記基板とは別の絶縁体により形成され、前記基板上に設けられた部品と、を具備し、

前記部品は、前記信号配線との間に前記絶縁体を介して対向する第 1 パターン、前記接地パターンと接続される第 2 パターン、および前記第 1 パターンおよび前記第 2 パターンとの間を接続してなる第 3 パターンを有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

前記第 1 パターンは前記部品の内部に設けられ、

前記第 1 パターンと前記第 3 パターンとを接続するビア配線を具備することを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置。

【請求項 3】

前記部品は、前記第 2 パターンと前記第 3 パターンとの間であって、前記部品の側面に、前記第 3 パターンより幅の大きい第 4 パターンを有することを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の半導体装置。